

证券代码：002449

证券简称：国星光电

## 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211124

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p>2021年11月17日、18日、19日：中信建投、沅京资本、招商证券、珀源私募、广州国平才富信息科技有限公司、广东帮您成长信息科技有限公司等6家机构投资者。</p> <p>2021年11月23日（“2021年走进上市公司”交流活动）：广发证券、广发基金、易方达基金、百嘉基金、金鹰基金、粤开证券、国信证券、万联证券、知本复利、西域投资、广州金控资产管理、安信证券、金新投资、深圳金钻资产、智合远见、广东华辉创富投资管理、海通证券、佛山宜利资产管理、广东弘彦资产管理、广东宝新资产管理、丹阳资本、深圳市向日葵投资、融捷集团、善一投资、恒昇基金、金灿资本、天鸾基金、渔当道等30余家机构投资者。</p> <p>2021年11月24日：中欧基金、华创证券等2家机构投资者。</p>
<b>时间</b>	2021年11月17日-11月24日
<b>地点</b>	国星光电南区中座一楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长王佳，总裁李程，常务副总裁欧阳小波，财务总监唐群力，董事会秘书袁卫亮，董事会办公室（投资证券部）主任董园园，组件事业部总经理蔡启明，RGB器件事业部副总经理、研究院副院长秦快，白光事业部副总经理、研究院副院长谢志国，证券事务代表何宇红，组件事业部主任工程师刘发波。

投资者关系  
活动主要内  
容介绍

**问题 1、上游芯片全资子公司国星半导体目前的经营情况、公司对其未来发展定位及展望。**

答：经过 2020 年下半年以来的战略调整，加上公司向国星半导体 2.2 亿元增资计划的稳步推进，其产品结构得到进一步优化：目前国星半导体以 RGB 芯片、倒装芯片、紫光芯片等利基型产品为主，同时研发布局 Mini 和 Micro 领域，形成了 Mini 背光和 Mini 显示两大系列的芯片产品，同时发挥上下游垂直联动的优势，协同本部研究院进行 Micro LED 关键技术的攻关；在第三代半导体领域，联合多所高校及研究所，发挥产学研协同优势，展开 GaN 功率器件、紫外探测器芯片、深紫外 UVC 芯片等方向的研究工作，参与两项第三代半导体方向的省级研发项目。

国星半导体是公司全力推进“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”的发展战略的重要部署，对公司发展具有协同创新的效应，公司将其发展提高至战略高度，未来也将通过更多的手段和方法支持上游芯片业务发展，推动实现产业变革。

**问题 2、公司在第三代半导体的布局情况及在第三代半导体领域的优势。**

公司一直高度关注三代半领域的技术发展与技术研究，致力于打造高可靠性、高品质的功率器件封测业务。在上游芯片领域，公司有布局硅基氮化镓的外延芯片；中游封装领域，公司已建成第三代半导体功率器件实验室及试产线；下游应用领域公司也在积极与相关企业洽谈战略合作，并针对客户的应用需求定制开发样品等。

首先，LED 封测转向氮化镓封测在技术上、工艺上、可靠性、能力上具有天然的优势；其次，公司下游客户也会用到第三代半导体相关功率器件，具有客户渠道协同的优势；同时，我们还具有外延芯片上的技术积累优势，子公司国星半导体有硅基氮化镓芯片相关技术储备。

**问题 3：公司毛利水平与同行存在差异的原因。**

公司的业务结构和同行业其他公司有所差异，一方面公司芯片业务基于公司体量、行业竞争等因素，毛利水平相对较低，另一方面公司的贸易业务基于其业务特点毛利水平也偏低，这两个板块对公司的整体毛利水平有所影响，单从公司封装业务的毛利情况来看，处于同行较好水平。后续公司将持续通过调整产业结构、稳步推进实施相关扩产计划，结合研发创新、降本控费、市场开拓及细分领域发展等多举措提升毛利水平。

**问题 4：公司在 Mini&Micro 领域的产品及技术布局。**

公司聚焦 Mini& Micro LED 超高清显示领域，持续推出有核心竞争力的产品系列：Mini LED 方面，公司研发覆盖了 Mini 直显 P0.4 到 P0.9 全系列产品，其中 Mini LED P0.4 系列产品为全球首发，采用独创 20in1 封装方式，是目前全球封装密度最高的 Mini 产品；Mini 背光方面，公司储备 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三大技术路线，可满足不同客户定制化需求；Micro LED 方面，发挥子公司国星半导体与本部上下游联动优势，巨量转移工艺取得突破性进展，产品良率高，同时国星半导体已开发了面向于 P0.3 间距及面向 P0.1 间距的 Micro LED 芯片系列，并实现小批量供货给国星光电研究院。

**问题 5：据三季报显示，公司的在建工程较 2020 年年末增加 752.42%，原因及投入的项目方向？**

主要系因扩产所需，新增机器设备购置以及进行厂房建设影响所致，设备这块主要是“新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目”，厂房建设这块主要是公司“吉利产业园项目”。

**问题 6：公司产品能否用于智能穿戴。**

公司立足自身技术优势，推出基于传感技术的新品——智能健康感测器件，可广泛应用于智能手表、智能手环等设备场景，为智能穿戴产业的加速发展提供有力的技术支撑。公司智能健康感测器件主要由发射器 1816 系列及接收器 3220 光敏系列组成。目前，该智能健康感测器件已实现量产，并积极与国内外头部品牌厂商联手

	合作，共同发力可穿戴设备领域。
附件清单	无
日期	2021年11月17日-11月24日